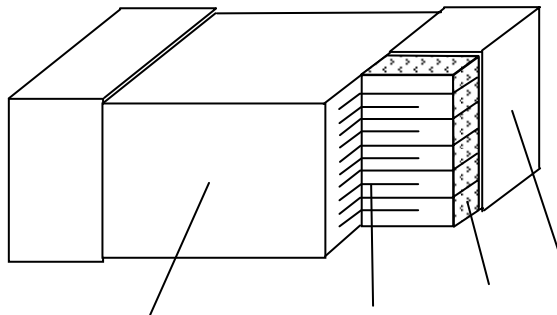


チップポジスタ 構造材質図
Chip POSISTOR Construction

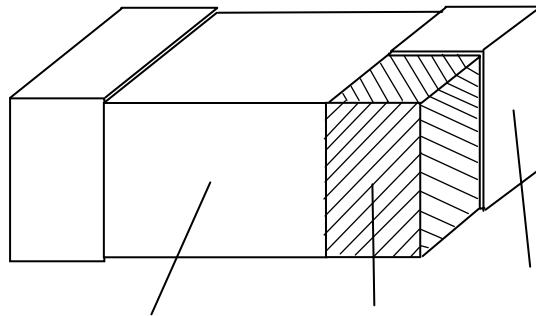
(PRG*****M***)



No.	材料 Material
	BaTiO ₃ 系セラミック半導体 BaTiO ₃ Semiconductive Ceramics
	内部電極 (Ni) Inner electrode (Ni)
	下地電極 (Ni 合金層) Electrode (Ni Alloy)
	Sn めっき Sn Plating

チップポジスタ 構造材質図
Chip POSISTOR Construction

- ・PR*****B1R*
- ・PR*****B2R*
- ・PR*****S1R*
- ・PR*****S2R*



No.	材料 Material
	BaTiO ₃ 系セラミック半導体 BaTiO ₃ Semiconductive Ceramics
	下地電極 (Ni 合金層) Electrode (Ni Alloy)
	Sn めっき Sn Plating

* 内部電極はありません。

* Non Inner-electrode